

府大の学生、卒業生が
参加できます

Fledge★

ビジネスアイデア コンテスト2019

応募〆切
2019/10/04

府大関係者の
「あったらいいな」を大募集！



A41枚で
応募可能



総額賞金
25万円+α



手厚い事前
サポート

予選会: 2019/10/12(土)
13:00~17:00

本選会: 2019/11/03(日)
9:30~11:45

詳細はこちらをチェック！



下記URLからお申し込みください
右のQRコードからURLに移動できます
<http://jinzai.osakafu-u.ac.jp/?p=1447>

お問い合わせ先
高度人材育成センター Fledge事務局
〒599-8531 大阪府堺市中区学園町1-1
TEL:072-254-9838 FAX:072-254-8274
CSieS@21c.osakafu-u.ac.jp